

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临2015-005号

金圆水泥股份有限公司关于参股公司与 控股子公司相关债权债务进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年9月，因金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴同润科技有限公司（以下简称“同润科技”）债务纠纷案，本公司持有苏州市置业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）100%股权中51%的股权被苏州市中级人民法院裁定给同润科技，由此苏州置业成为本公司持股49%的参股公司。苏州置业在作为本公司的全资子公司期间与本公司及本公司其他各控股子公司之间已存在资金往来关系。

为解决上述资金往来，2014年2月，本公司及本公司各控股子公司与苏州置业签署了解决资金往来的《协议书》，并经本公司2013年度股东大会审议批准。各方确认截至2013年12月31日，苏州置业应偿还本公司控股子公司太仓中茵科教置业有限公司（以下简称“太仓中茵”）34,464,775.08元，并分三年还清债务本金及利息。同时，苏州置业及其控股子公司苏州华锐置业有限公司（以下简称“华锐置业”）亦作出承诺：如苏州置业在还款期限内无法按本协议约定偿还资金本金及利息，苏州置业或其控股子公司华锐置业将以其等价值的房产等资产作价向太仓中茵偿还应付本金及利息。（具体公告已刊登于2014年2月22日、3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

根据《协议书》的约定，苏州置业应于2014年12月31日前向太仓中茵还款1100万元，截止本公告日，太仓中茵尚未收到苏州置业应偿还的该笔资金。为此，公司已分别致函苏州置业和太仓中茵：

1、苏州置业应按照《协议书》约定尽快还款或制定切实可行的还款计划，并报太仓中茵及本公司；

2、太仓中茵作为债权人，应继续敦促苏州置业安排还款或制定还款计划，并采取相关措施确保债权人相关权益不受损害。

目前，本公司与债权债务各方正在沟通协商，争取早日妥善解决该事项。上述1100万元债权（占公司2013年度经审计净资产6.35%）不会影响公司日常生产经营活动。本公司将继续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年1月14日